

厦门华侨电子股份有限公司

关于公司及控股子公司 2021 年度预计向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年12月14日，厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司2021年度预计向银行申请综合授信额度的议案》。

一、申请授信额度的情况：

为保证公司及控股子公司日常经营管理和新增业务拓展的资金需求，2021年度公司及控股子公司拟向各家银行申请总额不超过1亿元的综合授信额度，具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司实际控制人或其控制的企业将视具体情况为上述授信提供连带保证担保，属于关联交易。该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条相关规定，公司就该项交易豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

二、独立董事发表独立意见如下：

公司及控股子公司拟于2021年度向各家银行申请总额不超过1亿元的综合授信额度，系公司经营发展融资需要，不存在损害公司及股东的利益，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合公司的整体利益，同意将议案提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事长指派相关人员在授信额度范围内办理每笔流动资金贷款、贸易融资贷款、银行承兑汇票、票据贴现、抵（质）押等业务的相关手续及相关法律文件的签署。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2020 年 12 月 14 日